

Axion® T2000

고해상도 CD-SAXS 계측 시스템은 복잡하며 높은纵横 비율의 3D 낸드 및 DRAM 소자 구조를 위한 빠르고 정확하며 비파괴적인 3D 형상 측정을 제공합니다.

혜택 :

Axion® T2000은 혁신적인 엑스레이 기술을 활용하여 기억소자 기능 또는 성능에 영향을 줄 수 있는 미세한 구조적 변화를 식별합니다. 고해상도 및 비파괴적인 3D 소자 형상 측정을 제공함으로써 Axion T2000은 첨단 기억소자 제조업체에게 다음과 같은 도움을 줍니다.

- 연구개발 중에 빠른 학습 주기를 달성함에 따라 FIB-SEM, TEM, 단면 SEM과 같은 긴 소요 시간과 파괴적인 측정 방법에 대한 의존도를 감소시킵니다.
- 새로운 공정, 설계 노드 및 소자의 빠르고 정확한 특성화 및 최적화를 통해 생산량 증대 주기를 가속화합니다.
- 핵심 공정의 인라인 단계를 모니터링해 양산 중 소자 품질에 영향을 미치는 변동이 확인되고 신속하게 해결되도록 합니다.

기술 :

- 비파괴적인 CD-SAXS 측정 기술
- 높은 선속 엑스레이 광원
- 최대 회절 차순 분리
- 고해상도 검출기
- 업계 최고의 동적 범위의 AOI (입사 각도) 측정 받침대를 갖춘 정밀 모션 제어
- AcuShape® 모델링

응용분야 :

- 공정 특성화 및 최적화
- 엔지니어링 분석
- 인라인 공정 모니터링
- 식각 공정 설비 모니터링
- PM(예방 정비) 후 식각 공정 설비 검증



시장 :

반도체 칩 제조
3D 낸드 및 DRAM를 포함한 첨단
설계 노드 기억 소자

플랫폼 :

- 사용자 지정 구성
- 확장 가능
- 300mm 웨이퍼

추가 정보 :

www.kla.com/ko/products/chip-manufacturing/metrology#axion